

主な仕様

対象基板サイズ	50×50～400×500 mm
対象基板厚	0.5～2.5 mm
最大基板重量	約 3.0kg
対象部品	一般的なSMD: QFP、SOP、BGA、CSP、LGA 等
最大部品高さ	基板上側 45 mm(max) 基板下側 25 mm(max)
XYテーブル	微調整範囲 X: ±約 5 mm Y: ±約 5 mm
Z軸操作	ステッピングモーター駆動
トップヒーター	中赤外線コイルヒーター 800W (200W×4)
ボトムヒーター	広域タイプ 遠赤外線 IRヒーター 1000W (250W×4) 局所タイプ 中赤外線 IRヒーター 800W (200W×4) ※どちらか選択
ワイドボトムヒーター(オプション)	遠赤外線 IRヒーター 1000W×4
ITTS II 自動温度プロファイル運転	AP モード(PKG 表面+基板裏面のセンサーで制御)
設定ステップ	温度設定 4ステップ+クールダウン
(Mモード)	設定 6ゾーン+クールダウン トップヒーター 0～450 °C ボトムヒーター 0～600 °C 時間設定 0～999 秒
(Dモード)	設定4ゾーン+クールダウン トップヒーター 0～300 °C ボトムヒーター 0～300 °C 時間設定 0～999 秒
冷却時間設定	0～999 秒
操作部	TFT カラー、10 インチ、タッチパネル表示器
ビジョン	ビームスプリッタ式 ストレート/分割 切換可
対象視野範囲	45 mm□(MAX)
ズーム倍率	約 20～72 倍(カメラ倍率)
θ調整角度	±約 ≤5°
使用モニター	タッチパネル内表示 (外部出力可、信号形式 NTSC)
グラフ表示範囲	Y-300°C X 500 秒 5CH(5色)
データ保存数	250 ファイル (D=100/AP=100/M=50)
データ保存形式	CSV ファイル形式
記録媒体	コンパクトフラッシュメモリーカード
対応温度センサー	K 型熱電対
電源電気容量	AC200 V 単相 50/60Hz 約 2.5KVA(ワイドボトム時 約 4.5kVA)
外部エア	ドライエア 0.5 MPa～0.8 MPa

装置寸法 680(W) × 780(D) × 725(H)mm ※タッチパネル格納時
 730(W) × 780(D) × 725(H)mm ※タッチパネル展開時

本体重量 約 80kg

本体外形図

